

ニッケルレス最終表面処理プロセス

銅上の無電解金めっきプロセス

トップギルドプロセス

Electroless Gold Plating Process on Copper Circuit
TOP GILD PROCESS

Final Surface Treatment Process without Nickel Plating

銅上への無電解パラジウム/金めっきプロセス

トップパラスプロセス

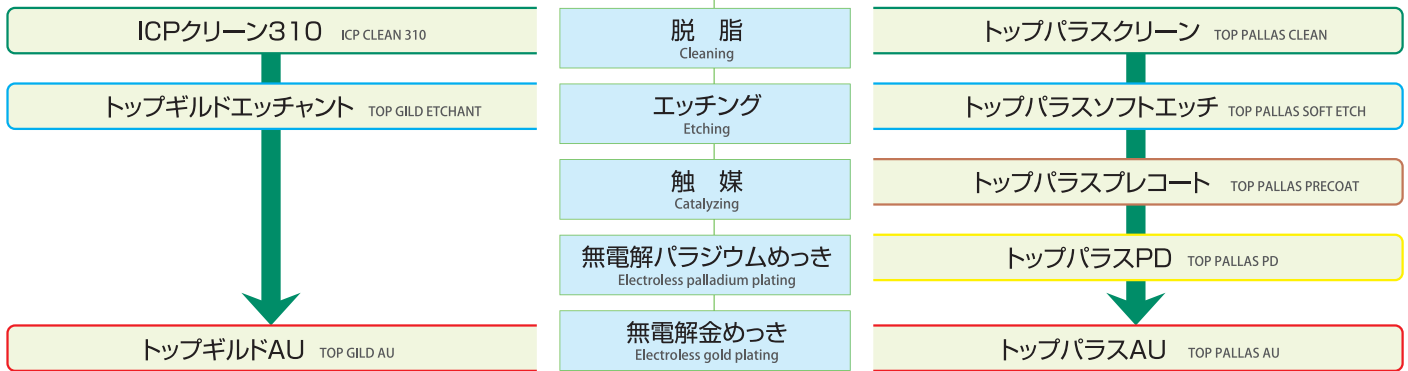
Electroless Palladium / Gold Plating Process on Copper Circuit
TOP PALLAS PROCESS

- 銅上の金析出性が良好
 - 下地銅の腐食がほとんど無く、つきまわり性が良好
 - ファインパターン性に優れる
 - Roll to Roll仕様にも対応
- Good deposition ability of gold plating on copper
 - Prevent copper damage, excellent in covering performance
 - Excellent fine pattern ability
 - Applicable to Roll to Roll plating system

- 銅上のパラジウム析出性が良好
 - はんだ接合性、金ワイヤボンディング性に優れる
 - 耐折性、耐食性が良好
 - ファインパターン性に優れる
- Good deposition ability of palladium plating on copper
 - Excellent in solder joint, gold wire bonding performance
 - High folding endurance, great corrosion resistance
 - Excellent fine pattern ability

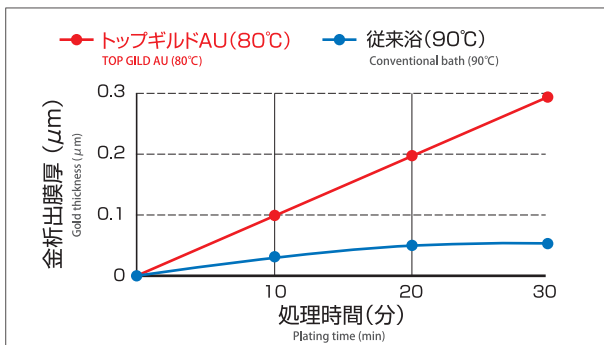
処理工程

Process



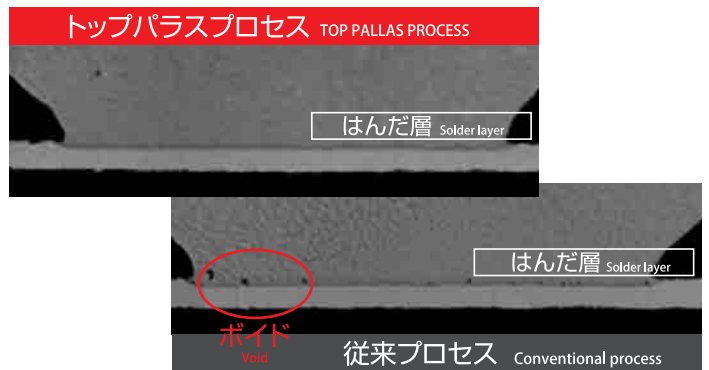
良好な析出性

High deposition performance



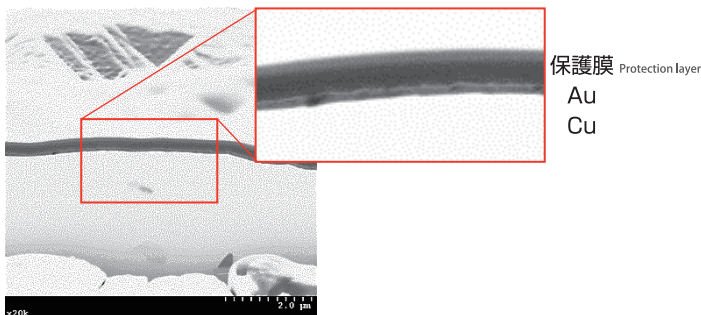
優れたはんだ接合性

High solder joint performance



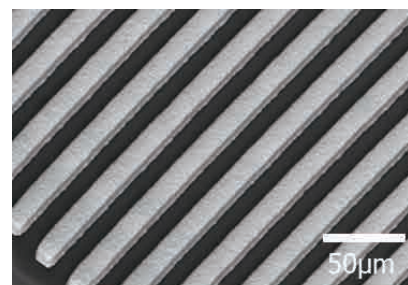
銅上への良好なつきまわり性

Improve covering performance on copper



優れたファインパターン性

Excellent fine pattern ability



L/S=15/15μm